

硅谷数模 2021 校园招聘招聘简章

东南大学站

一、 公司背景

硅谷数模半导体公司是全球领先的高性能混合信号半导体产品设计厂商，使高清无处不在，带来“轻松便携、任意屏幕”的移动式高清晰度体验。硅谷数模使移动设备能够在任意的高清显示设备（包括内部系统屏幕、电脑显示器和电视）上呈现应用 APP、电影和图片，并且同时优化电池寿命。

硅谷数模的 IP 核心、全自定义的 ASIC 和成熟的数字媒体集成电路通过 DisplayPort™和 HDMI™等行业标准接口提供端到端连接，广泛应用于世界领先品牌推出的数百万当今最流行的消费电子设备。

总部： 中国苏州

其他地点： 美国硅谷，中国北京，中国深圳，台湾，韩国以及日本

行业领域： 数字多媒体和通信领域，高性能模拟和混合信号半导体的领导者

产品价值

首款经 VESA DisplayHDR™400 认证的超低功耗时序控制器

第一个 DisplayPort™ 转四 MIPI-DSI 显示控制器 (SlimPort® ANX753x/7580 系列产品)，用于头戴式虚拟现实和增强现实显示设备时，支持的最高帧速率为 120fps

第一个 10Gbps 单芯片 USB-C 承载 DisplayPort 重定时器 and USB-C 开关 (ANX7440/30)，可用于笔记本电脑，台式电脑和二合一可转换笔记本电脑

第一个支持 4K 分辨率和 60fps 帧速率的单芯片发送器 (SlimPort® ANX7688)，支持 USB-C 承载 DisplayPort，为智能手机和平板电脑设计

为第一台 5K 分辨率监视器 (Dell UltraSharp 27) 设计的 LCD TCON

为第一台 4K 分辨率笔记本电脑 (华硕) 设计的 LCD TCON

SlimPort，第一款低功耗移动设备到 HDMI 显示器的 USB 连接方案

CoolHD™，全世界首个也是唯一的零功耗 HDMI 发送器

第一款通过 VESA 认证的 DisplayPort 发送器

中国第一款 HDMI 接收器

率先推出 DisplayPort 发送技术

率先提供距离 25 米的 HDMI 接收方案

率先生产出 6.25 Gbps 的 Serdes PHY 芯片

率先提供 1 千米的 10Base-T 以太网芯片

二、 招聘职位 (JD 见文末)

数字电路设计工程师/ASIC Design Engineer、模拟电路设计工程师/Analog Design Engineer、验证工程师/Verification Engineer、后端设计工程师/Backend Design Engineer、应用工程师 /Application Engineer、产品软件工程师/Software Engineer

【专业需求】微电子、集成电路、微固体电子学、半导体物理电子与器件、电子、电路、通信、计算机、通信工程、软件、自动化控制等相关专业

2020 届及 2021 届全日制理工科背景本科与硕士毕业生

☆📍【工作地点】江苏苏州

加入我们群会了解更多，有 HR 小姐姐互动答疑



行动派、Joseph@东南大学



该二维码 7 天内 (10月21日前) 有效，重新进入将更新

三、★【宣讲时间地点】

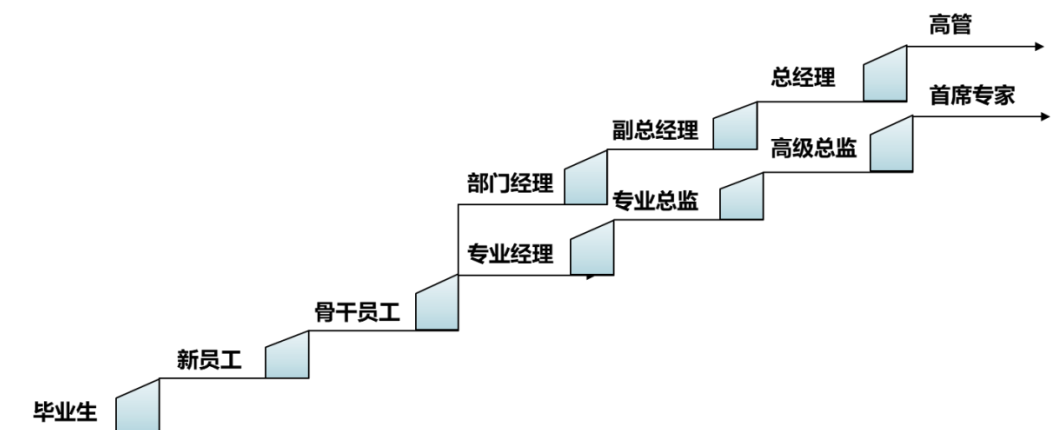
10月20日 18:00~21:00

四牌楼校区 东南院 102

宣讲会福利：校招直通车，宣讲现场安排笔试，第二天面试

三、职业路径

专业、管理双通道发展体系：在硅谷数模，你将有机会深入学习专业技能，协同参与项目管理。是变身技术专家，还是升级管理大咖，你的道路由你选择！



四、福利保障

薪资结构：固定工资、年终奖金、补助

福利体系：常规福利：法定节假日、带薪年假、五险一金

现金福利：异地安家费、餐饮补助及其他；

保险福利：补充医疗保险；

医疗福利：免费员工体检；

五、 招聘流程

简历投递、线下笔试、现场面试、远程面试、发放 offer、安排实习、正式入职

六、 岗位详细 JD

数字电路设计工程师/ASIC Design Engineer

1.Design and implement digital circuits in advanced CMOS technology.

设计先进 CMOS 技术和实现数字电路；

2.Understand how circuits work.

理解电路的工作原理；

3.Develop and improve new and existing circuit solutions.

开发和改进新的和现有电路解决方案；

4.Receive technical feedback at reviews.

接收技术反馈评论；

5.Document RTL design and communicate with other designer.

与其他设计师沟通文档 RTL 设计内容于方案；

6.Support system and field application engineers.

支持系统和现场应用工程师；

模拟电路设计工程师/Analog Design Engineer

1. Participate in IC product design.

参与 IC 产品的设计；

2. Responsible for the design, verification, test, debug and other specific work of relevant analog circuit.

负责完成相关模拟电路的设计，验证，测试，debug 等具体工作；

3. Provide instructions and requirements for layout, matching, current density, etc., and check with relevant tools.

对版图的布局，寄生效应，匹配性，电流密度等提供指导和要求，并利用相应工具检查；

4. Participate in IC design project work, complete tasks with quality and quantity guaranteed;

参与对 IC 设计项目工作，保质保量完成任务。

5. Provide layout guidance to back-end engineers, cooperate with digital engineers in chip design, support system engineers in testing.

为后端工程师提供版图指导，与数字工程师合作芯片设计，支持系统工程师测试；

6. Organize summary design documents.

整理总结设计文档。

验证工程师/Verification Engineer

1.Understand the expected functionality of designs.

了解设计的预期功能;

2.Develop testing and regression plans.

制定测试和回归计划;

3.Design and develop verification environment.

验证环境的设计与开发;

4.Run RTL and gate-level simulations/regression.

运行 RTL 和 gate-level 模拟/回归;

5.Code/functional coverage development, analysis and closure.

代码/功能覆盖开发、分析和结束;

6.Release the documents during the verification flow, such as verification plan, usage of the verification environment, simulation result of test cases, verification coverage report, etc.

发布验证流程中的文档, 如验证计划、验证环境的使用、测试用例的模拟结果、验证覆盖率报告等。

后端设计工程师/Backend Design Engineer

1. Responsible for the physical design process of the chip from Netlist to GDSII.

负责芯片从 Netlist 到 GDSII 的物理设计流程;

2. Responsible with layout and wiring, physical verification, power consumption voltage drop analysis, parasitic parameter extraction, DRC&LVS and other physical design processes.

负责布局布线、物理验证、功耗压降分析、寄生参数提取, DRC&LVS 等物理设计流程;

3. Responsible whole Chip, Block level, timing analysis from Frontend to Backend, understanding of synthesis, formal validation, Netlist quality check.

从 frontend 到 backend 的时序分析, 了解综合, 形式验证, Netlist quality check.

应用工程师/Application Engineer

1. Develop the chip module validation plan and implement.

制定芯片模块验证方案和计划, 切实执行计划;

2. Report chip or application issues to JIRA system and track resolution.

汇报芯片或应用问题到 JIRA 系统并且追踪解决;

3. Cooperate with Marketing Department to promote new products.

配合市场部新品推广;

4. Support FAE to solve customer problems.

支持 FAE 解决客户问题;

5. Document development and maintenance.

文档制定及维护。

产品软件工程师/Software Engineer

1.Working with Product marketing(PM), Design team(R&D) and Application Engineering(AE) team to create software/firmware for products.

与产品市场部(PM), 设计团队(R&D)和应用工程团队(AE)一起为产品创建软件/固件;

2.Analyzing solution requirements, design and validation strategies.

分析解决方案需求、设计和验证策略;

3. Define software/firmware requirements and writing design documentation.

定义软件/固件需求并编写设计文档;

4. Cooperate with team to develop software solutions for products.

与团队合作开发产品的软件解决方案;

5. Support application engineer(AE) and field application engineer(FAE) to support customer.

支持应用工程师(AE)和现场应用工程师(FAE)为客户提供支持.



关注我们，了解更多信息